



表面贴装型 CX2016SA (消费类电子产品应用/ 移动通信应用/ 车载应用)

2.0×1.6mm



AEC-Q200 RoHS指令对应产品

■特点

- 广泛的应用
- 小型、薄型(2.05×1.65×0.45mm)
- 陶瓷封装
- 可对应回流焊

■用途

- ECU
- 车载摄像机
- 数字家电
- 移动通信

■型号表示方法

CX2016SA 20000 D0 G S S CC
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ①系列名称
- ③负载容量

D0 8 pF

- ②频率
- ④频率容差
(常温偏差)

G ±15×10⁻⁶

- ⑤工作温度范围以及⑥频率温度特性

SS	-40 ~ +125 °C	±50×10 ⁻⁶
TW	-40 ~ +150 °C	±200×10 ⁻⁶

- ⑦个别规格(产品目录以CC标示)

包装方式(载带包装 3000/ 15000个/卷盘)

■规格

项 目	记 号	标准规格	单 位	备 注
频率	f _{nom}	16, 20, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 37.4, 38.4, 40, 48, 50	MHz	其他频率, 敬请咨询。
泛音次数	OT	Fundamental	—	
负载容量	CL	8	pF	其他负载容量, 敬请咨询。
频率容差	f _{tol}	±15	×10 ⁻⁶	25 °C ±3 °C
串联电阻	R1	Table 1	ohm	
激励级	DL	10μW(200μW max.)	μW	
工作温度范围	T _{use}	-40 ~ +125 -40 ~ +150	°C	
储存温度范围	T _{stg}	-40 ~ +150	°C	
频率温度特性	f _{tem}	±50 ±200	×10 ⁻⁶	对于25°C频率的偏差

以上规格为规格示例, 如需其他规格, 敬请咨询。

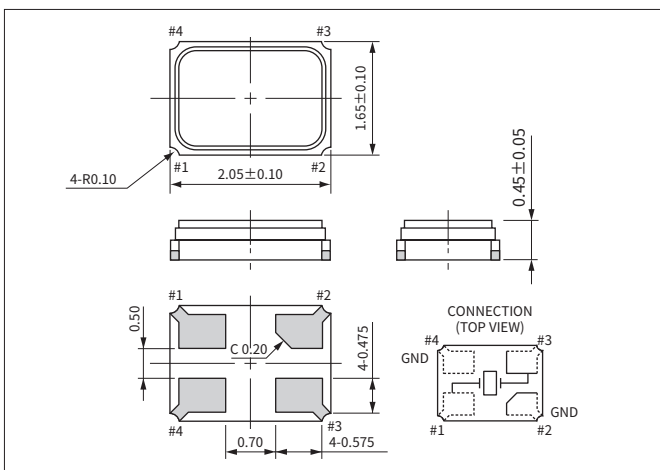
■Table1 串联电阻

其他频率, 敬请咨询。

频率范围	串联电阻
16MHz	200Ω max.
20MHz	150Ω max.
32MHz	60Ω max.
50MHz	50Ω max.

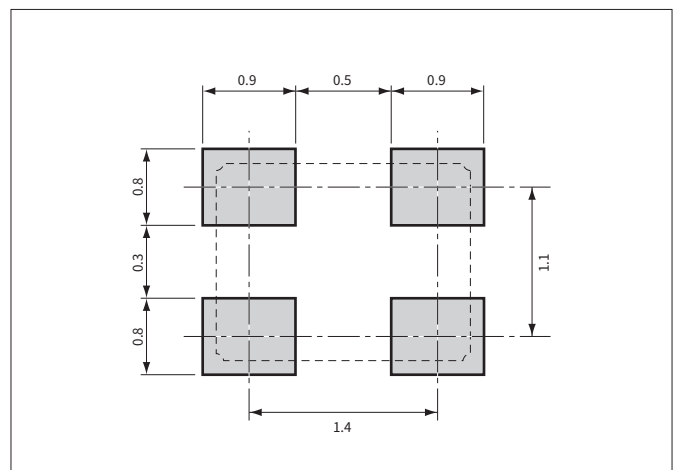
■外形尺寸

(单位: mm)



■推荐焊盘图案

(单位: mm)



晶体谐振器

